

证券代码：688807

证券简称：优迅股份

## 厦门优迅芯片股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2026-003

|               |   |   |
|---------------|---|---|
| 投资者关系活动类别     | <input type="checkbox"/> 特定对象调研<br><input type="checkbox"/> 媒体采访<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会<br><input type="checkbox"/> 现场参观<br><input type="checkbox"/> 其他  | <input type="checkbox"/> 分析师会议<br><input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 电话会议 |
| 参与单位名称        | 参与了本次业绩说明会的线上投资者  |   |
| 时间            | 2026年4月29日下午3点-4点   |   |
| 地点            | 上海证券报·中国证券网路演中心（网址： <a href="https://roadshow.cnstock.com/">https://roadshow.cnstock.com/</a> ）   |   |
| 上市公司接待人员      | 董事、总经理：柯腾隆<br>独立董事：周剑扬<br>副总经理：陈哲、刘伯坤<br>董事会秘书兼财务总监：杨霞  |   |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会采用网络远程的方式举行，业绩说明会互动问答的主要内容如下：</p> <p><b>1. 请问公司未来三年的战略规划？</b></p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司以成为国际光通信、光传感收发芯片领先企业为核心战略目标，致力于提供从芯片到组件的完整解决方案。未来三年，公司将在巩固现有155Mbps至100Gbps产品批量出货、特别是25G、100G电芯片在数据中心及5G无线领域批量落地的基础上，持续围绕高速光通信、硅光集成、车载光电等方向加大投入，布局关键专利形成技术壁垒。</p> |   |

长期来看，公司将以光通信电芯片技术为核心平台，聚焦于电信侧、数据中心侧及终端侧三大高增长领域的应用场景开发。在电信侧，公司巩固在接入网、5G 等领域的优势，加速 FTTR（光纤到房间）产品升级，完成 50G PON 全系列产品开发，满足下一代宽带接入需求；在数据中心侧，同步突破单波 100G、单波 200G 高速数据中心电芯片技术，并积极推进下一代的相干光收发芯片研发，以支撑长距离、大容量传输场景，进而重点攻关 800G/1.6T 硅光组件，为超高速数据中心和骨干网提供低功耗、高集成度解决方案；在终端侧应用领域，公司将集中资源开发 FMCW 激光雷达核心芯片组，同时积极布局车载光通信电芯片组的研发与客户送样，满足车规级高可靠性要求，加速在智能汽车领域的应用落地。同时，积极布局机器人等新兴场景，前瞻性地把握终端侧智能化的巨大市场机遇。感谢您的关注！

## 2. 公司在光通信领域今年的主要规划能否说下？

答：尊敬的投资者您好！2026 年，公司将围绕整体战略与募投规划，以技术创新、市场洞察双轮驱动，紧抓 AI 算力、固网升级、车载光电的产业变革机遇，持续推进产品迭代与新业务布局，加速从光通信电芯片隐形冠军，向光通信、光传感芯片及综合解决方案服务商升级，助力产业链自主可控。公司已实现 155Mbps 至 100Gbps 速率光通信电芯片产品的批量出货，其中 25G、100G 电芯片已在数据中心、5G 无线传输等领域实现批量落地，为公司的持续发展奠定了坚实基础。研发端，公司将持续推动高附加值新产品的研发与产业化进程：在电信侧，公司正积极推进 50G PON 系列产品的研发攻坚与测试验证，深化与头部系统商的战略合作，加速产品从样品研发到规模化量产的过渡，力争在下一代固网接入市场确立核心竞争地位。在 AI 算力领域，公司正围绕

400G/800G/1.6T 光收发芯片的市场化落地展开工作，推动客户对既有样品的验证，并进一步完善单波 100G/200G 速率产品，尽快实现量产。在相干领域及硅光组件方面，公司正推进相干 128Gbaud 高速光通信电芯片的量产落地，并同步进行下一代相干光收发芯片研发。在终端侧，公司正集中资源开发 FMCW 激光雷达核心芯片组与车载光通信电芯片组，以满足车规级高可靠性要求，并加速相关产品的落地进程。此外，公司将持续布局下一代先进技术及产品预研工作，丰富技术储备，筑牢技术壁垒。

市场端，针对 50G PON、AI 计算、相干光通信及车载领域，公司将与头部客户保持紧密协同，针对不同细分场景需求，共同定义产品、协同测试验证，并适时启动新速率、新形态产品的开发，把握产品趋势，为后续创造更多商业机会。感谢您的关注！

**3. 今年股价还会继续创新高吗？公司在市值管理这块是如何安排的？**

答：尊敬的投资者您好！感谢您的关注。二级市场股价受宏观经济、行业周期、市场情绪、资金流向等多重因素综合影响，股价走势无法预判，公司不便对二级市场价格及涨跌做出任何判断或承诺。公司始终高度重视市值管理与股东价值维护，坚持聚焦主业经营，持续夯实核心竞争力、提升经营质量与盈利能力，严格合规做好信息披露，积极维护资本市场良好形象。后续公司将持续做好生产经营、内控治理、投资者关系管理等各项工作，以稳健可持续的经营业绩回报广大投资者。谢谢！

**4. 您好，请问公司高速率电芯片的产业化进展如何？**

答：尊敬的投资者您好！公司单波 100Gbps 系列电芯片（主要包括 TIA、Driver 产品）进展顺利，已完成工程片流片，预计今年三季度实现芯片回片，并同步推进客户验证工作。同时，公司已搭建完成单波 100G 速率产品的研发与测试技术平台，完成高速率 PAM4 线性收发芯片核心 IP 的性能验证，形成完整的单波 100G PAM4 收发芯片设计开发能力，为后续产品规模化量产奠定坚实基础。

单波 200Gbps 方面，公司围绕 1.6T 光模块应用积极布局下一代速率产品，重点研发跨阻放大器、VCSEL 激光器驱动器，以及面向 LPO/NPO 架构的 MZ 调制器驱动器等核心芯片。

公司完成了 128Gbaud 相干光通信电芯片套片的设计迭代，该套片是针对城域网、骨干网及数据中心互联的高性能解决方案。产品已通过部分头部客户送样验证，并获得后续合作意向。公司正进一步拓展产品在数通领域的相干下沉应用，持续挖掘市场增量空间。感谢您的关注！

**5. 请问公司单波 100G、单波 200G 高速数据中心电芯片技术最新进展如何？128G 波特率相干 TIA 及 Driver 芯片已完成针对部分头部客户的送样验证结果如何？有订单吗？**

答：尊敬的投资者您好！针对 400G/800G 光模块应用，公司布局单波 100Gbps 系列产品，相关芯片已完成回片测试，并向业内主流模块企业送样进行摸底测试；在 2025 年深圳光博会上，公司成功进行了 800G VR8 及硅光 DR8 高速方案的现场演示，获得行业高度关注，充分展现技术前瞻性与研发实力。通过本轮研发，公司搭建了单波 100G 速率产品的研发、测试技术平台，验证了高速率 PAM4 线性收发芯片的核心 IP 性能，形成完整的单波 100G PAM4 收发芯片设计开发能力，为产品量产奠定坚实基础。

公司积极布局 1.6T 光模块应用的单波 200G 速率代际产品，研发跨阻放大器、VCSEL 激光器驱动器、用于 LPO/NPO 的 MZ 调制器驱动器等核心产品。

在长距离传输领域，公司完成了 128Gbaud 相干光通信电芯片套片的设计迭代，该套片是针对城域网、骨干网及数据中心互联的高性能解决方案。产品已通过部分头部客户送样验证，并获得后续合作意向。公司正进一步拓展产品在数通领域的相干下沉应用，持续挖掘市场增量空间。感谢您的关注！

**6. 目前公司在手订单充裕度怎样？高端产品出货占比是否提升？现有产能是否能匹配下游客户需求，有没有扩产或产能优化计划？**

答：尊敬的投资者您好！目前公司在手订单充足，整体经营态势良好。根据公司整体战略安排高端产品出货占比稳步提升，产品结构持续优化。

公司是 Fabless 企业，专注于芯片研发设计，生产环节委托晶圆代工及封测厂商完成。

公司现有产能能够较好匹配下游客户需求，同时将根据行业景气度及客户需求变化，持续深化与核心供应链厂商合作，积极推进产能优化与供应链布局，保障产品稳定交付，更好地支撑业务发展。感谢您的关注！

**7. 目前我们头部光模块客户的验证进展怎么样？**

答：尊敬的投资者，您好！公司深耕行业十余年，与核心客户建立了长期稳定、高度互信的合作关系，客户粘性显著；公司多款产品与下游客户有多年合作历史，目前多款产品正在核心客户导入过程中，具备成熟的高速量产测试能力，可高效响应头部客户产能配套需求。感谢您的关注！

**8. 贵公司在光模块 DSP 有布局吗？**

答：尊敬的投资者，您好！关于 DSP 布局：公司暂无规划。谢谢！

**9. 公司 2025 年报及 2026 一季报营收、利润波动原因是什么？今年下游光模块、通信设备行业需求景气度如何，全年营收和净利润有没有明确增长规划？**

答：尊敬的投资者，您好！公司 2025 年营业收入较上年同期增长 18.41%；归属于上市公司股东的净利润 8 较上年同期增长 13.18%；2026 年一季度营业收入较上年同期增长 17.57%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 20.04%；收入增长得益于行业需求持续向好：包括数据中心、无线接入领域，10Gbps 以下电芯片产品保持稳健增长，25Gbps-100Gbps 电芯片产品陆续完成核心客户的导入与认证工作，进一步切入高端市场，为公司持续发展打开新的增长空间；接入网领域，国内运营商稳步保持 FTTR 推广节奏，公司借助千兆宽带升级的市场机遇，产品需求逐步提升，带动接入网业务收入稳步增长。

2026 年下游光模块、通信设备行业高景气延续。公司经营情况良好，相关经营计划与财务目标，请以公司后续在指定信息披露平台发布的公告为准。感谢您的关注！

**10. 400G/800G 光模块用单波 100Gbps 系列产品，预计何时能批量量产？**

答：尊敬的投资者，您好！公司单波 100Gbps 系列电芯片（主要包括 TIA、Driver 产品）进展顺利，正在进行工程片流片，预计今年三季度实现芯片回片，并同步推进客户验证工作。同时，公司已搭建完成单波 100G 速率产品的研发与测试技术平台，完成高速率 PAM4 线性收发芯片核心 IP 的

性能验证，形成完整的单波 100G PAM4 收发芯片设计开发能力，为后续产品规模化量产奠定坚实基础。感谢您的关注！

**11. 请问公司未来的分红计划和派息政策？**

答：尊敬的投资者您好！公司高度重视投资者的合理回报，在兼顾经营业绩可持续发展的前提下，积极践行稳健的现金分红政策。2025 年度，每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税），截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 80,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 28,800,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红总额占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 32.68%。未来公司将继续统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，继续落实稳健的分红政策，在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，切实分享企业发展成长红利，提升投资者获得感。感谢您的关注。

**12. 请问美国的高新技术控制政策对于公司的经营有无实质性影响？**

答：尊敬的投资者，您好！美国的高新技术控制政策对于公司的经营无实质性影响，感谢您的关注！

**13. 当前高速光模块用电芯片供需情况如何？公司在研 100G、200G 速率电芯片有何优势？**

答：尊敬的投资者您好！

当前全球 AI 算力需求爆发，800G/1.6T 高速光模块进入快速放量期，带动高速电芯片呈现需求旺盛、供给偏紧、国产替代加速的行业格局。

公司单波 100G、单波 200G 电芯片主要面向 800G、1.6T 及下一代高速光互联场景，在带宽性能、低功耗、线性度等关

键指标上具备行业竞争力，可较好适配 LPO/NPO/CPO 等先进架构，同时在集成度与成本控制上具备明显优势。

目前相关产品研发与客户验证工作正按计划推进，有助于公司进一步巩固在高速电芯片领域的技术壁垒，提升高端产品竞争力。

感谢您的关注！

**14. 今年研发投入重点在哪些技术方向？面对行业同行竞争，公司在产品壁垒、客户结构上有哪些核心优势，后续有无新业务或新品落地预期？**

答：尊敬的投资者，您好！公司持续聚焦高附加值新产品研发与产业化落地，电信侧稳步推进 50G PON 系列产品研发攻坚、测试验证及规模化量产配套，深化与头部系统厂商战略合作；AI 算力领域重点推进 400G/800G/1.6T 光收发芯片客户送样验证，迭代完善单波 100G/200G 速率产品，加快量产进程。相干及硅光组件板块，推进 128Gbaud 相干高速电芯片量产落地，同步开展下一代相干芯片前瞻研发；终端车载方向集中研发 FMCW 激光雷达核心芯片组、车规级光通信电芯片组，严格按照车规标准推进产品落地。

公司在国内电芯片行业具备多重难以复制的核心竞争优势：一是在高速线性收发、CDR 等关键技术领域拥有深厚技术积累，产品性能与可靠性已通过规模化商用验证；二是深耕行业十余年，与核心客户建立了长期稳定、高度互信的合作关系，客户粘性显著；三是深度绑定产业链上下游，与头部厂商开展联合定制开发及前瞻性技术预研，能精准匹配客户需求；四是具备成熟的高速量产测试能力，可高效响应头部客户产能配套需求。

在 50G PON、AI 计算、相干光通信及车载领域，公司将与头部客户保持紧密协同，针对不同细分场景需求，共同定义产

|                       |  |
|-----------------------|--|
|                       | 品、协同测试验证，并适时启动新速率、新形态产品的开发，把握产品趋势，为后续创造更多商业机会。感谢您的关注！                  |
| 附件清单（如有）              | 无  |
| 风险提示                  | 以上如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或公司管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。 |
| 关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明 | 本次活动不涉及应当披露重大信息。   |
| 日期                    | 2026年04月29日  |